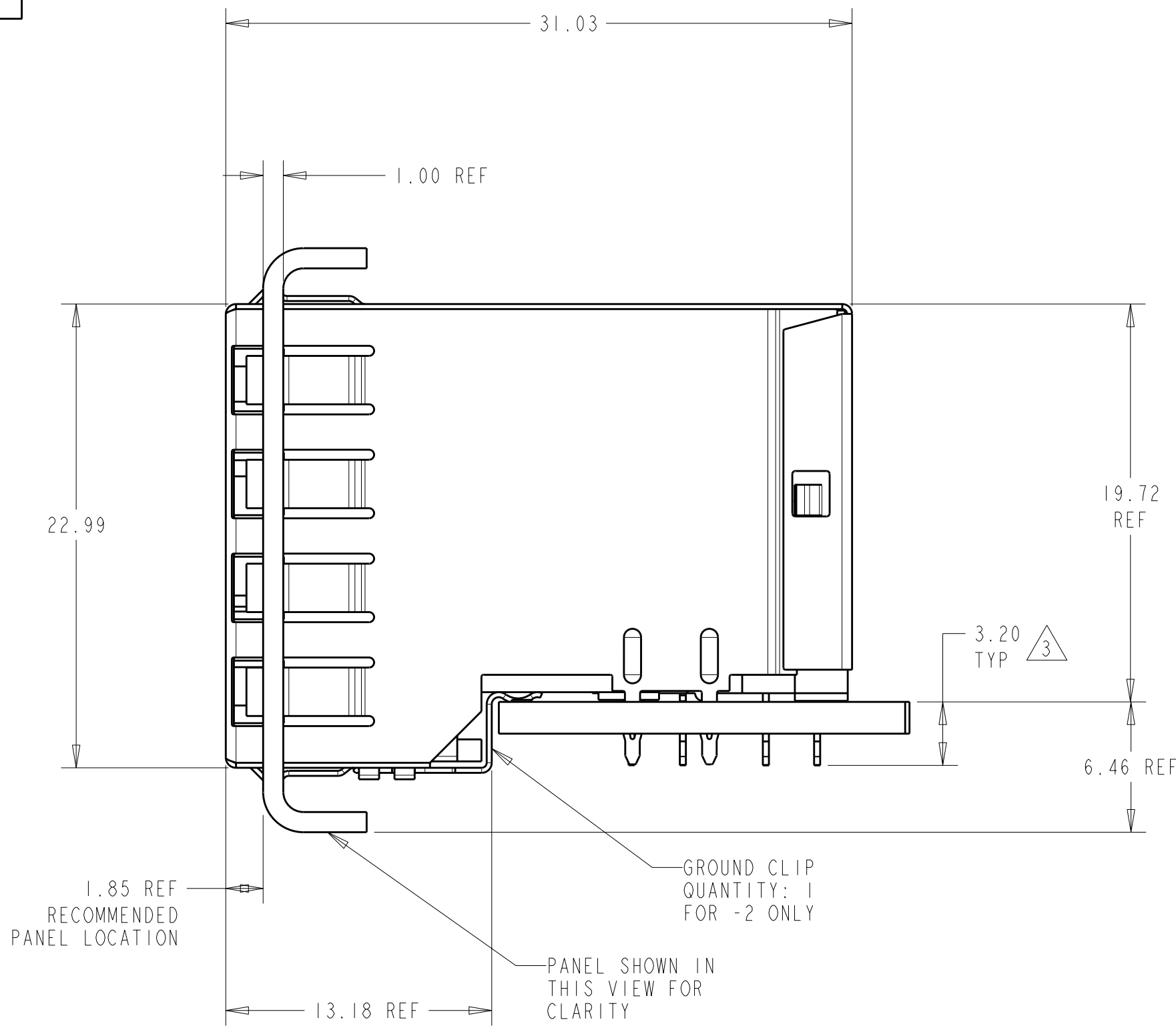
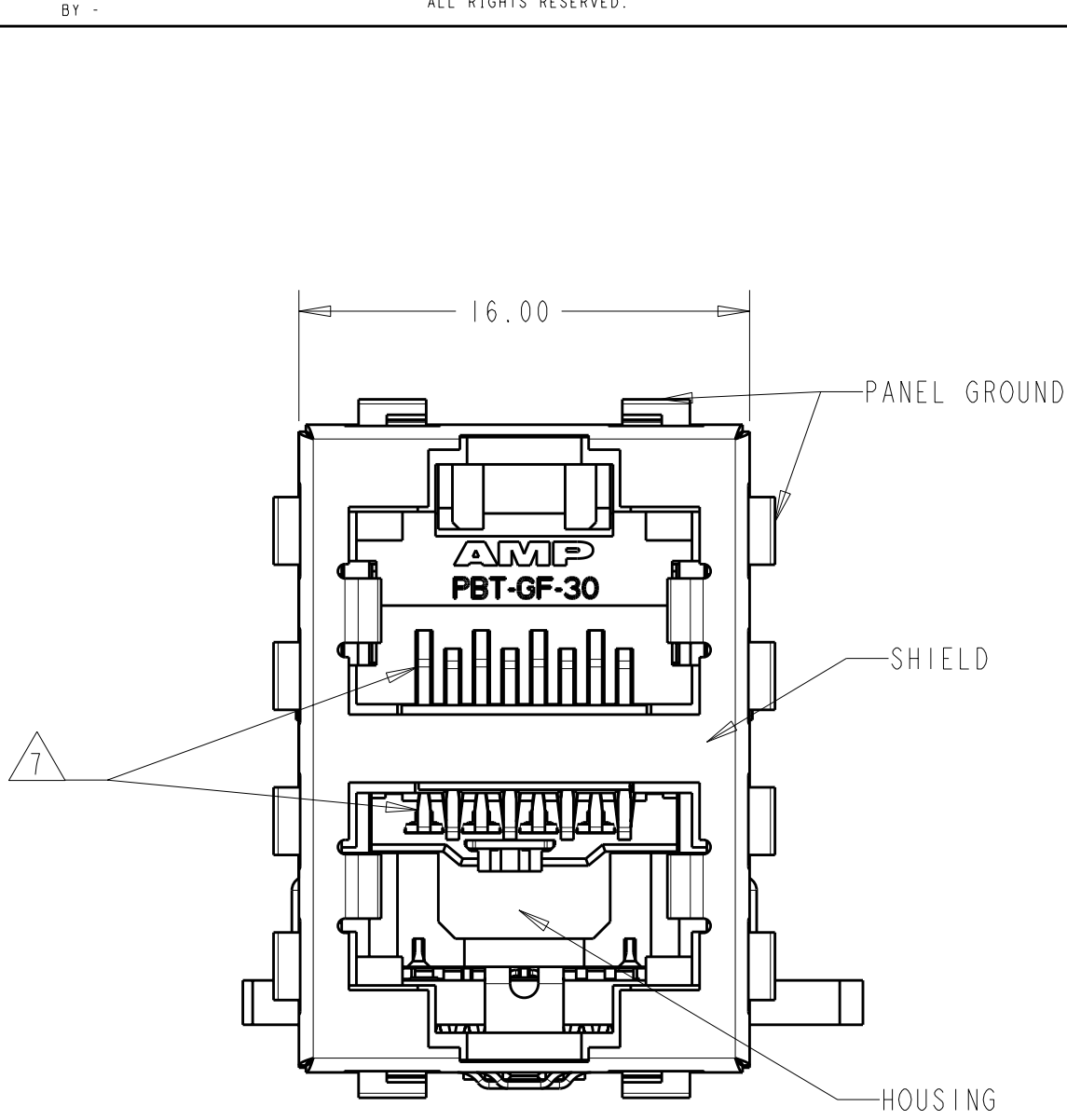


D

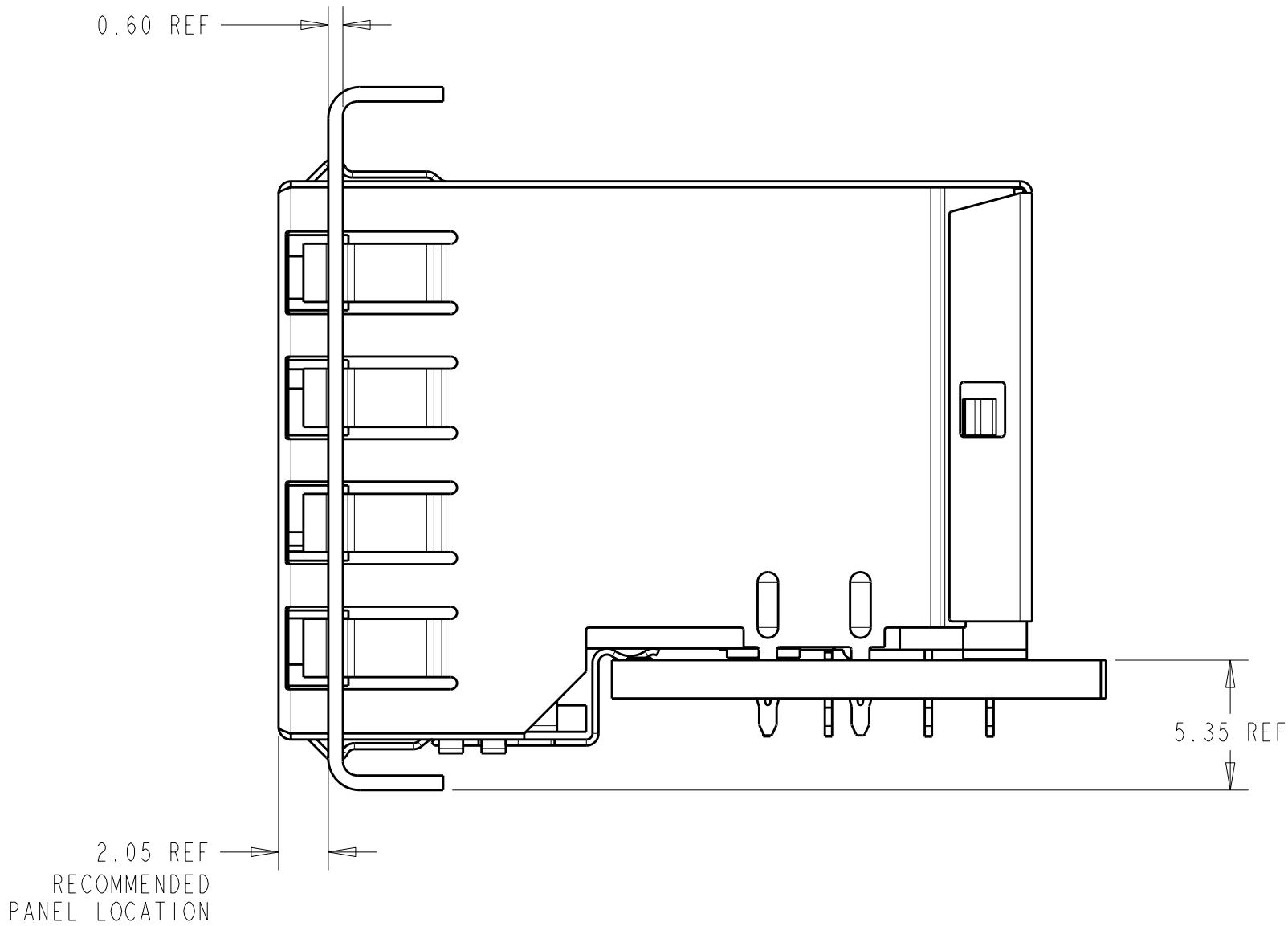
C

B

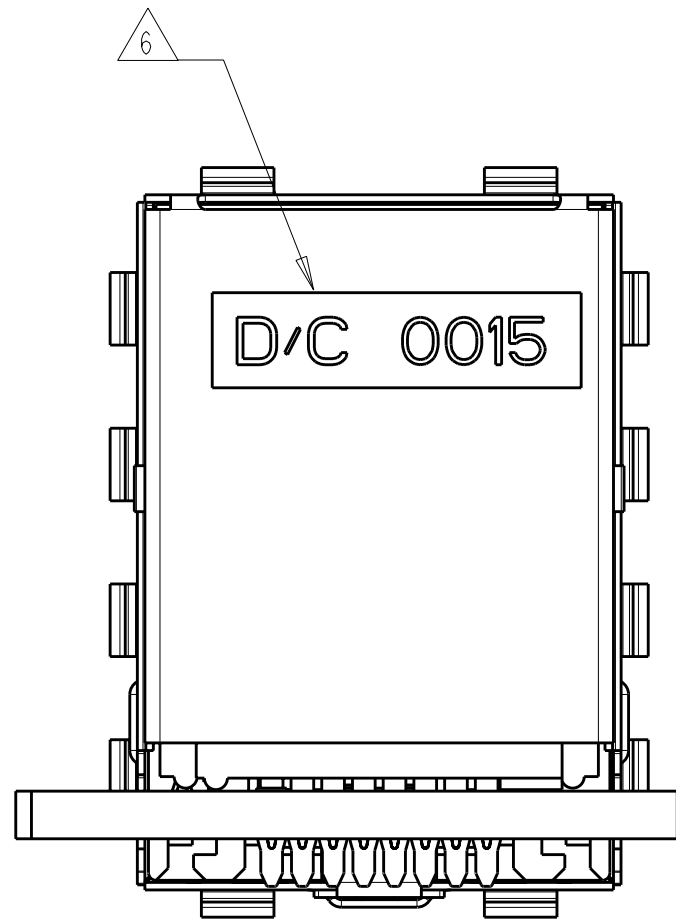
A



ATCA PANEL AND
PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY LAYOUT



AMC PANEL AND
PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY LAYOUT



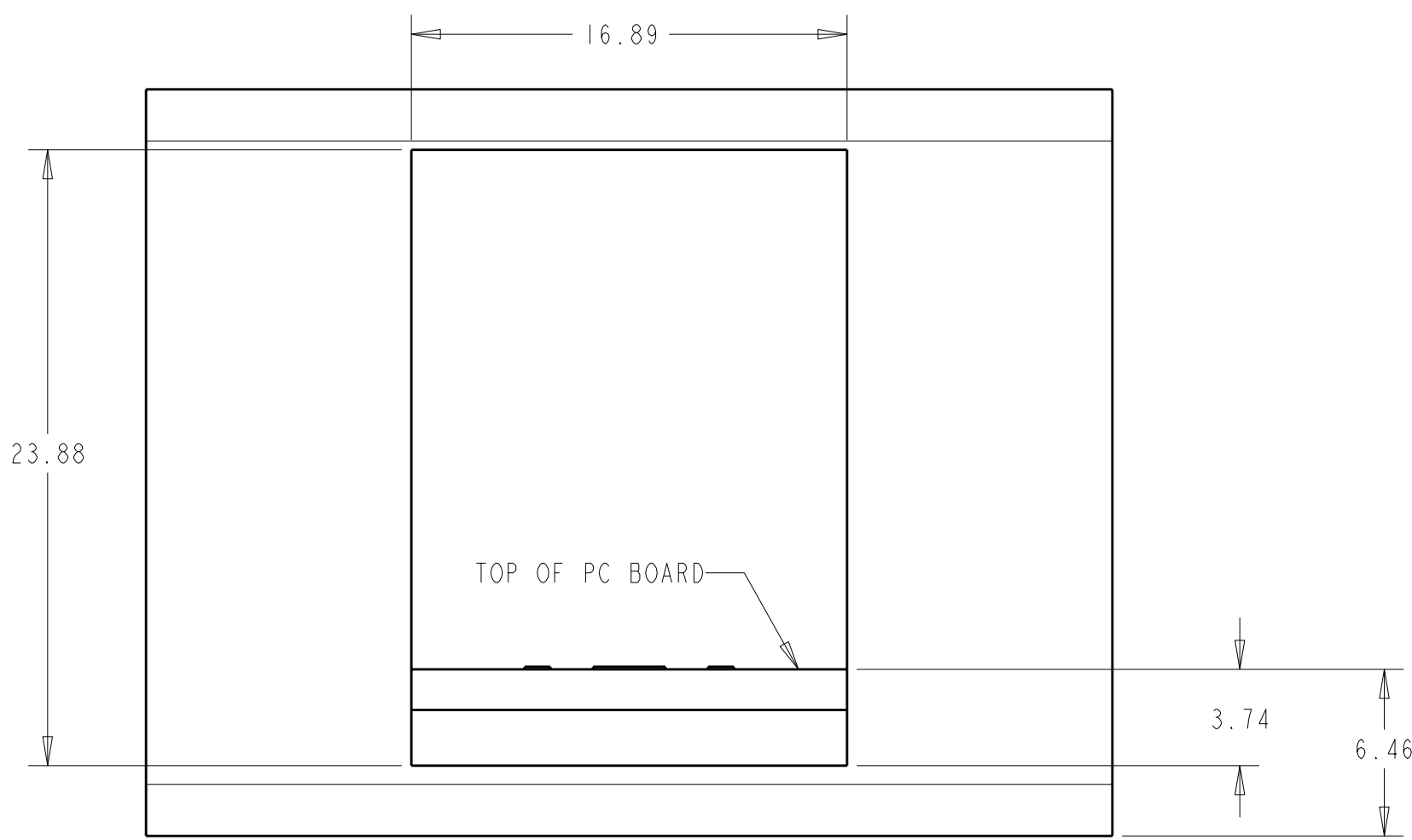
1. MATERIAL:
HOUSING:
PBT POLYESTER, BLACK, UL 94V-0
TERMINALS:
0.33 THICK PHOSPHOR BRONZE PLATED WITH 1.27µm MINIMUM THICK
HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81µm MINIMUM THICK
TIN IN ACTION PIN COMPLIANT PIN TERMINAL AREA
OVER 1.27µm MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE
SHIELD:
0.25 THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 2.03µm MINIMUM TIN
OVER 1.27 µm MINIMUM NICKEL
GROUND CLIP: 0.25 THICK COPPER ALLOY PRE-PLATED WITH 2.03µm
MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL
2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS, PART 68
SUBPART F.

- 3 MAXIMUM PIN LENGTH 3.40 FROM TOP SURFACE OF PC BOARD
4 FINISH PLATED THRU HOLE DIAMETER
ANNULAR RING DIAMETER 1.3 TO 1.5
5 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER
6 DATE CODE LOCATED ON REAR OF PART APPROXIMATELY AS SHOWN
7 CONTACTS ARE NOT INTENDED TO BE ALIGNED WITH EACH OTHER

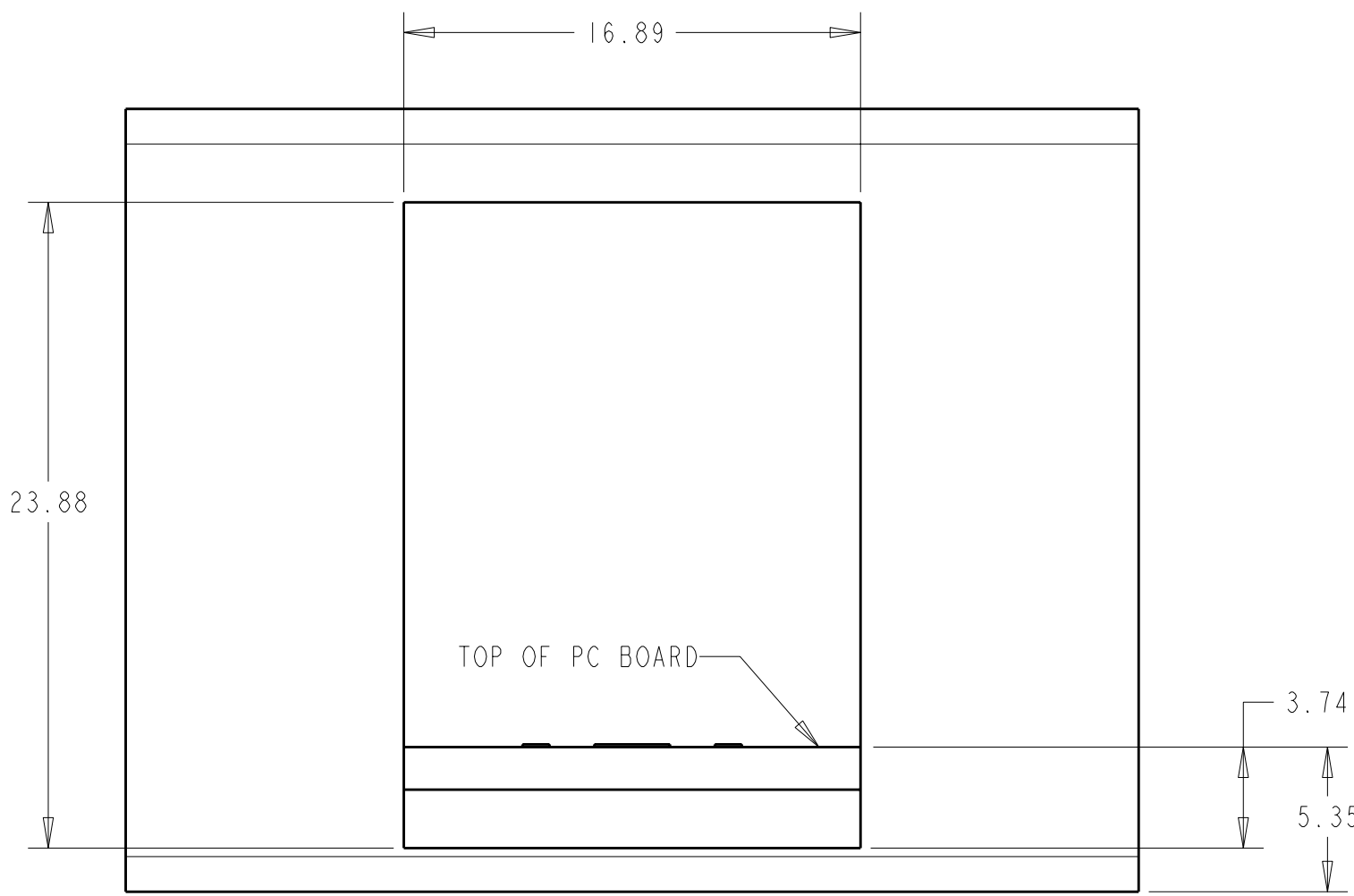
15.88	WITH GROUND CLIP	1888652-2 (SHOWN)
16.13	WITHOUT GROUND CLIP	1888652-1
M DIM	DESCRIPTION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN L.A.MAYER 16OCT2006	 TE Connectivity				
		CHK J.WESTMAN 16OCT2006					
DIMENSIONS:		APVD S.FLICKINGER 16OCT2006	NAME				
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PRODUCT SPEC	STACKED MOD JACK ASSEMBLY, 2 X 1,				
		108-1854	2 POSN, RJ45, SHIELDED, PANEL				
	9 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ±	APPLICATION SPEC	GROUND, OFFSET, CAT 5				
		114-2160					
MATERIAL SEE NOTE 1	FINISH	WEIGHT	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
		-	A1	00779	C=1888652	-	
		CUSTOMER DRAWING	SCALE	2:1	SHEET	1 OF 2	REV C2

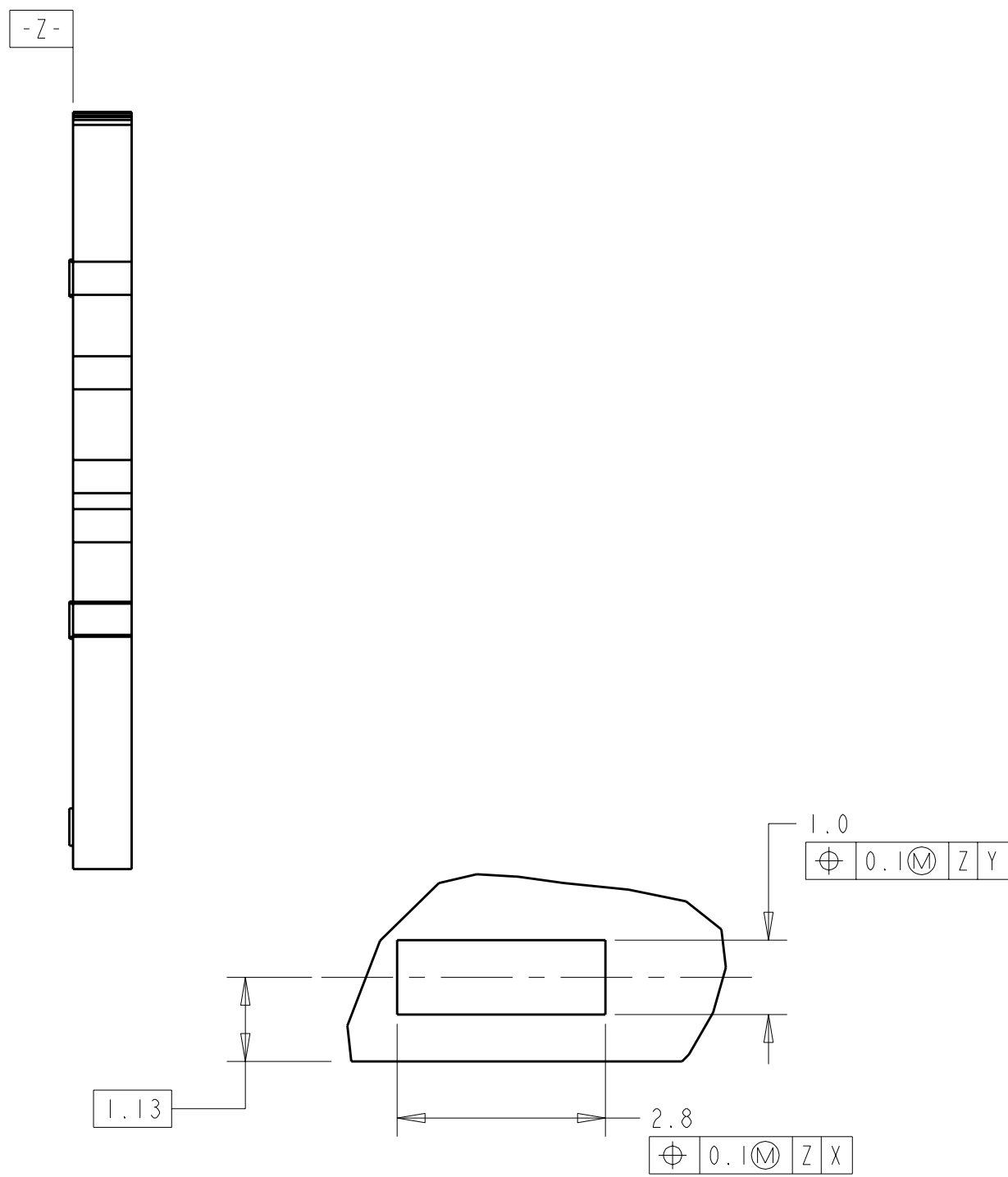
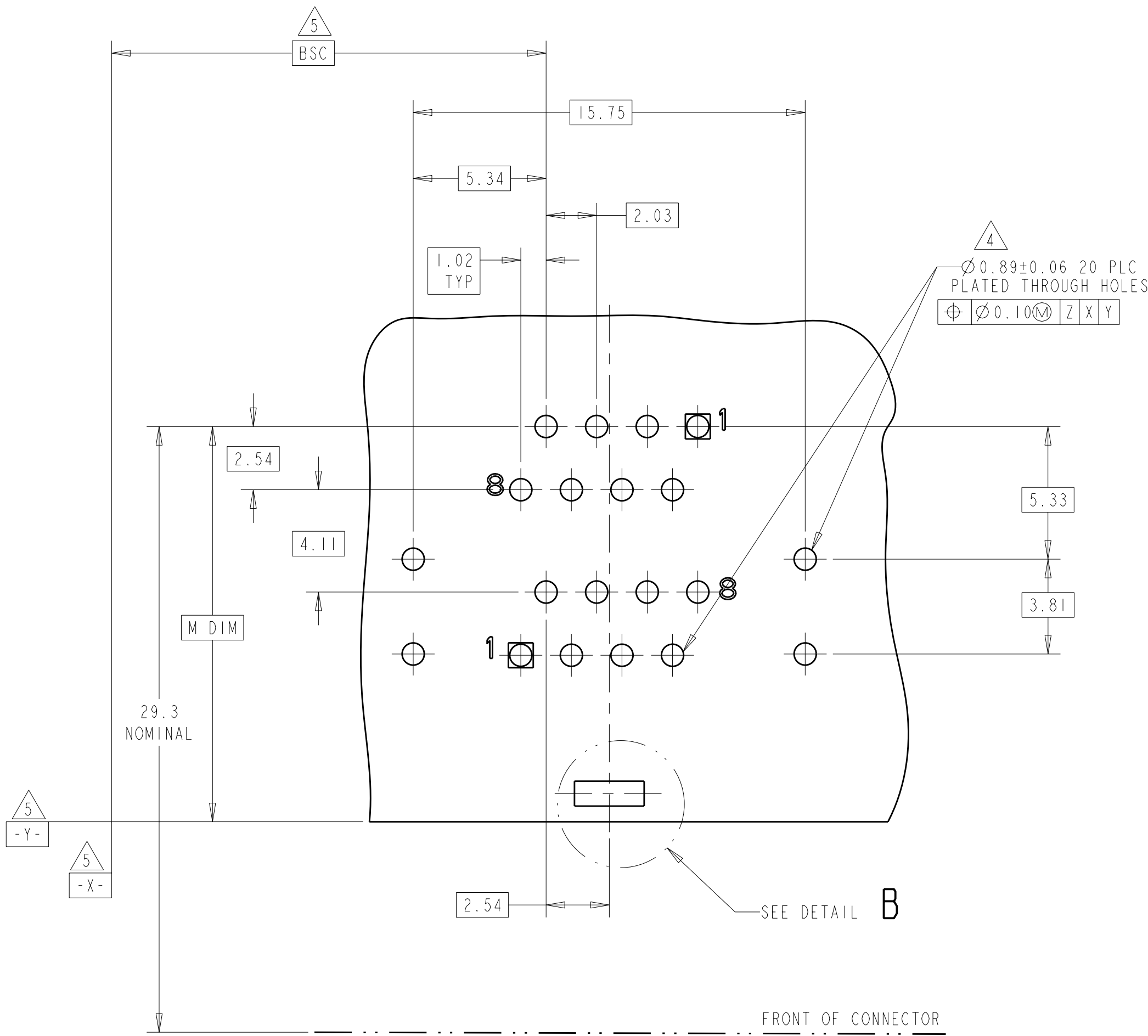
LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
AA	00	-	-	SEE SHEET 1	-



ATCA PANEL AND
PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT



AMC PANEL AND
PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT



DETAIL B
SCALE 12:1
PLATED PADS REQUIRED FOR
1888652-2 (PRODUCT WITH
GROUNDING CLIPS)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN L.A.MAYER 16OCT2006	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK J.WESTMAN 16OCT2006		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD S.CLICKINGER 16OCT2006	NAME STACKED MOD JACK ASSEMBLY, 2 X 1, 2 POSN, RJ45, SHIELDED, PANEL GROUND, OFFSET, CAT 5	
mm		PRODUCT SPEC	SIZE	
9 PLC ±		108-1854	CAGE CODE	
1 PLC ±0.13		APPLICATION SPEC	DRAWING NO	
3 PLC ±		114-2160	RESTRICTED TO	
5 PLC ±		WEIGHT	A1 00779 C=1888652	
4 PLC ±		FINISH	SCALE	
ANGLES ±1°		CUSTOMER DRAWING	4:1	
MATERIAL SEE NOTE 1			SHEET	
			2 OF 2	
			REV	
			C2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9